

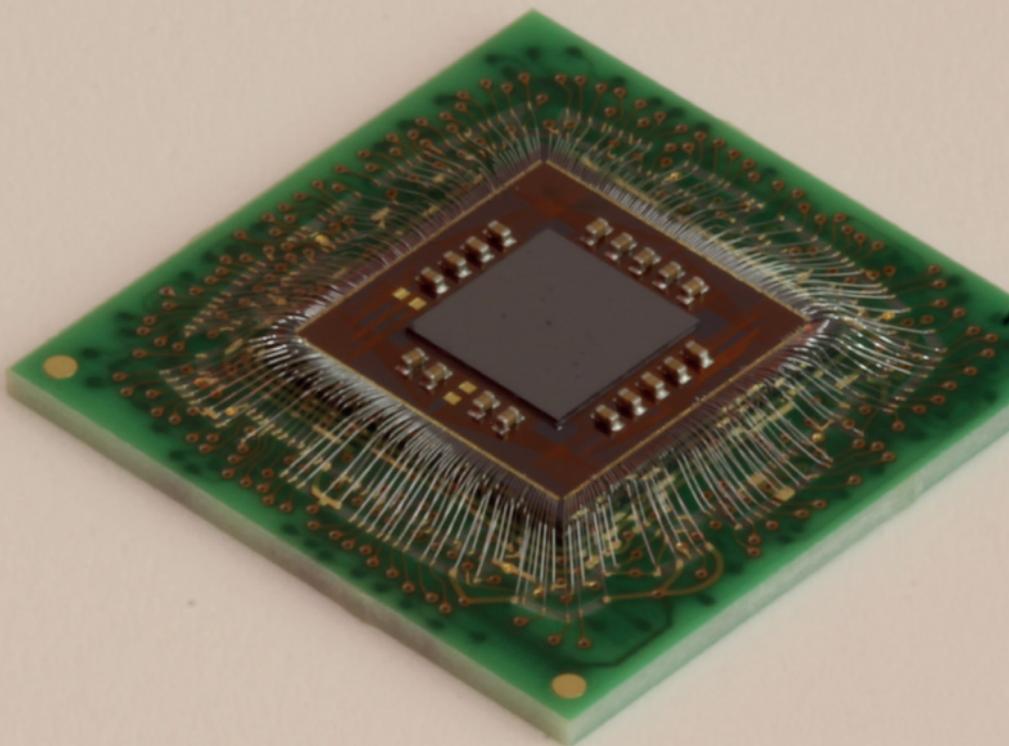


Fraunhofer
ENAS

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
ELEKTRONISCHE NANOSYSTEME ENAS

16. JUNI 2021 | 13:00 – 17:10 UHR
CHEMNITZER SEMINAR DIGITAL

EINBLICKE IN DAS ELEKTRONIK- UND MEMS-PACKAGING



PROGRAMM

MITTWOCH, 16. JUNI 2021

- 13:00 – 13:10 Uhr **Welcome** | Prof. Dr. Harald Kuhn und Dr. Maik Wiemer, Fraunhofer ENAS
- 13:10 – 13:35 Uhr **Physiologie des menschlichen Nervensystems im Mikrosystem nachgebaut: hier und jetzt oder noch ein Traum?**
Dr. Regina Luttmann, Eindhoven University of Technology
- 13:35 – 14:00 Uhr **Electronics Packaging: From Afterthought to Product Differentiator – Packaging Trends towards Chiplets Packaging**
Steffen Kröhnert, ESPAT Consulting
- 14:00 – 14:25 Uhr **Transferdruck bei X-FAB: Eine neuartige Technologie zur 3D-Integration**
Dr. Sebastian Wicht, X-FAB MEMS Foundry GmbH
- 14:25 – 14:55 Uhr **Lab-Tour:** Begleiten Sie uns auf eine Live-Tour durch unser Labor »Drucktechnologien« und erleben Sie unser neues 3D-Cluster-Tool in Aktion!
- 14:55 – 15:40 Uhr Networking-Pause
- 15:40 – 16:05 Uhr **Lasergestützte Fügeprozesse als Schlüsseltechnologie der zukünftigen Aufbau- und Verbindungstechnik**
Matthias Fettke, Pac Tech – Packaging Technologies GmbH
- 16:05 – 16:30 Uhr **Organic Free Packaging for MEMS-based IR Components Compared to Standard Packaging Technologies**
Matthias Günther, Micro-Hybrid Electronic GmbH
- 16:30 – 16:55 Uhr **Reaktives Bonden für Chip-Level-Anwendungen**
Klaus Vogel, Fraunhofer ENAS, und Ralf Schachler, Finetech GmbH & Co. KG
- 16:55 – 17:10 Uhr **Abschlussdiskussion**